【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年11月20日(2014.11.20)

【公開番号】特開2014-112694(P2014-112694A)
【公開日】平成26年6月19日(2014.6.19)
【年通号数】公開・登録公報2014-032
【出願番号】特願2013-273446(P2013-273446)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　23/12　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/60　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　23/12　５０１Ｐ
Ｈ０１Ｌ　21/92　６０３Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成26年10月1日(2014.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
チップであって、１またはそれ以上の電子デバイスを規定する基板と、前記チップのエリア内に位置づけられ、前記１つまたはそれ以上の電子デバイスに電気的に接続された１つまたはそれ以上のソルダ要素とを含み、前記基板と前記ソルダ要素との間に２つの耐衝撃バッファ層と、前記１またはそれ以上のソルダ要素を前記１またはそれ以上の電子デバイスに電気的に接続するために、前記バッファ層間に挟まれたパターニングされた導電層とを備え、前記バッファ層の各々は１．６Ｇｐａから２．４Ｇｐａの範囲のヤング率を有し、前記２つのバッファ層の各々は、約６．５μｍ～約１０μｍの範囲の厚みを有する、チップ。
【請求項２】
前記２つのバッファ層の各々は、約７．５μｍの厚みを有する、請求項１に記載のチップ。
【請求項３】
前記２つのバッファ層は、同一組成を有していている、請求項１または請求項２に記載のチップ。
【請求項４】
前記２つのバッファ層の各々は、約２ＧＰａのヤング率を有する、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のチップ。
【請求項５】
０．５ｍｍ以下のピッチ間隔で離間する前記ソルダ要素のアレイを備えた、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のチップ。
【請求項６】
０．４ｍｍ以下のピッチ間隔で離間する前記ソルダ要素のアレイを備えた、請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のチップ。
【請求項７】
前記１またはそれ以上のソルダ要素は、約４％ｗｔ．の銀および約０．５％ｗｔ．の銅を含む組成を有するスズをベースとしたソルダ要素である、請求項１から請求項６のいず

れか一項に記載のチップ。
【請求項８】
前記ソルダ要素はソルダボールである、請求項１から請求項７のいずれか一項に記載のチップ。
【請求項９】
前記ソルダ要素はソルダバンプである、請求項１から請求項８のいずれか一項に記載のチップ。
【請求項１０】
前記基板は、半導体ウェハである、請求項１から請求項９のいずれか一項に記載のチップ。
【請求項１１】
請求項１から請求項１０のいずれか一項に記載のチップと、前記１つまたはそれ以上のソルダ要素を介して前記チップに電気的に接続されたプリント回路基板とを備え、前記１つまたはそれ以上のソルダ要素は、前記チップと前記プリント回路基板との間に挟まれている、装置。
【請求項１２】
請求項１から１０のいずれか一項に記載のチップ、あるいは、請求項１１に記載の装置を含む無線通信装置。